

福建时创科技STR-BGA2000BGA返修台

产品名称	福建时创科技STR-BGA2000BGA返修台
公司名称	福建时创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:STR 型号:STR-BGA2000 pcb尺寸:Max 440 × 450mm Min 15 × 22mm
公司地址	福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区49号楼一层
联系电话	0591-88207880-8001 18065105933

产品详情

STR-BGA2000返修台

特点：

三温区控温系统上下温区为热风加热，IR预热区为红外加热

6段温度控制，精度 ± 3 ，IR预热区可调整加热面积，可同时显示七条温度曲线和存储多组用户数据，并具有瞬间曲线分析功能

外置测温接口可随时对实际采集BGA的温度曲线进行分析和校对

高清可调CCD彩色光学视觉对位系统，可调节成像清晰度，具有分光、放大、缩小微调和自动对焦，并配有自动色差分辨和亮度调节装置

加热装置和贴装头一体化设计，皮带传动，Z轴运动为步进控制系统，可精确控制对位点与加热点；能自动识别吸料和贴装高度，具有自动焊接和自动拆焊功能

配备多种规格钛合金BGA风嘴，该风嘴可360°任意旋转，易于安装和更换。配有形红外激光快速定位

全方面的观测BGA芯片的四角和中心点的对位状况，杜绝"观测死角"的遗漏问题

可储存多组温度设置参数和记忆多组不同BGA芯片加热点和对位点，并能在触摸屏上随时进行温度参数的曲线分析、设定和修正；同时不需依靠外接装置（电脑）即可通过自带的USB端口下载、打印、保存和分析曲线